

传音布局三折叠智能机 压力下频繁加码新业务

中经记者 陈佳岚 广州报道

“非洲手机之王”传音在三折叠手机产品上再次“秀肌肉”。

近日，来自传音控股（688036.SH）的消息称，传音旗下品牌 TECNO 推出三折叠概念机 TECNO PHANTOM Ultimate G Fold，采用 G 型双内折结构，配备 9.94 英寸柔性主屏与外屏设计，折叠状态下厚度为

三折叠手机发展现状

当前，三折叠手机成本高昂，受众面狭窄、技术难点颇多（如屏幕、铰链、软件系统的适配、功耗发热）是该产品市场推广的挑战。

传音旗下拥有 TECNO、itel 和 Infinix 三大手机品牌，包含功能机和智能机业务。事实上，记者留意到，在推出三折叠概念机 TECNO PHANTOM 之前，去年的 8 月和今年的 2 月，传音就通过 TECNO 品牌和 Infinix 品牌先后发布了三折叠概念机 PHANTOM ULTIMATE 2 以及竖向三折叠概念机 Infinix ZERO，但均未进入量产阶段，目前仍停留在技术展示阶段。

从行业情况来看，2024 年 9 月，华为发布全球首款三折叠屏手机 Mate XT 非凡大师，售价 19999 元起，该机型目前仍是全球唯一一款在售的三折叠智能手机。

三星也在积极布局三折叠手机市场，早在 2025 年年初的 MWC（世界移动通信大会）上，三星就展示了两款三折形态概念机 Flex G 和 Flex S，分别采用内折与 Z 字形折叠方案，并计划在 2025 年年底至 2026 年年初发布其首款三折叠手机。今年 7 月，三星移动业务负责人卢泰文宣布，三星计划在年底前推出一款三折叠智能手机。

据了解，当前，三折叠手机成本高昂，受众面狭窄、技术难点颇多（如屏幕、铰链、软件系统的适配、功耗发热）是该产品市场推广

11.49mm、展开后最薄处 3.49mm。传音方面称，该机型刷新三折叠手机轻薄纪录，成为全球最薄三折叠手机。

对此，Canalys 分析师钟晓磊在接受《中国经营报》记者采访时表示，传音推出三折叠概念机，意在通过技术“秀肌肉”提升品牌高端形象，拓展中高端市场布局，同时应对当前供应链成本压力及行业转型挑战。

的挑战。

而一些主流手机厂商对三折叠手机也持观望态度，表示短期内不会快速跟进。比如，此前，OPPO 中国区原副总裁刘波在接受记者采访时，谈到对三折叠产品布局态度时就表示：“内部有产品方案，但暂时不做，需求不是那么强烈。”

与此同时，荣耀前 CEO 赵明亦在一场公开直播中指出：“荣耀在技术层面也已具备推出三折叠屏手机的能力。后续会根据消费者需求来确定商业化的时间节点，三折叠不是技术问题，而是商业选择问题。”

在钟晓磊看来，硬件层面的技术难题并非阻碍三折叠手机上市的关键障碍，当前供应链与厂商预研已基本解决铰链、电池、内部堆叠及玻璃盖板等问题。三折叠手机市场目前面临市场需求不足、研发成本高昂而预估销量难以覆盖投入和软件适配复杂等挑战，尚未成为主流厂商优先布局的产品形态。华为积极推广三折叠屏是出于技术展示和品牌塑造的考量，三星此前也积极展示过三折叠概念机多用于展示技术实力和推动零部件销售，而 OPPO、vivo、小米等厂商更倾向于针对主流用户推出产品。

布局原因几何？

传音推出发布三折叠概念机并非追求销量，而是“秀肌肉”，拓展品牌市场空间并向高端走，意在摆脱低端标签。

传音方面向记者表示，TECNO PHANTOM Ultimate G Fold 目前暂无正式量产计划，但已具备量产能力。如 PHANTOM Ultimate 系列概念机一样，其核心想展示的是 TECNO 在折叠手机领域的前瞻性、创新工艺方面的领先技术实力和不断探索、推陈出新的创造力。TECNO 方面还预计，将于 2026 年 MWC 期间展示这款概念机。

在钟晓磊看来，传音推出发布三折叠概念机并非追求销量，而是“秀肌肉”，拓展品牌市场空间并向高端走，意在摆脱低端标签。

“自 2024 年下半年起，市场就面临较大的供应链成本上升压力。尤其是传音主力市场长期依赖的 100 美元（折合人民币约 718.46 元）以下超低端机型，毛利也面临较大压力。”钟晓磊向记者分析，传音此前已经发布了多款双折叠产品，随着三折叠概念的产品发布，可以看出，传音也想通过折叠屏产品拉升

频繁加码新业务

近年来，传音也一直在非洲、拉美市场加码布局消费电子市场之外的新增长业务，比如光伏储能、出行等。

除了拥有新兴市场知名手机品牌 TECNO、itel 及 Infinix 之外，传音旗下还包括数码配件品牌 oraimo、家用电器品牌 Syinix 以及售后服务品牌 Carcare。

值得注意的是，近年来，传音也一直在非洲、拉美市场加码布局消费电子市场之外的新增长业务，比如光伏储能、出行等。

在光伏储能领域，传音成立了钛氢能源科技发力储能业务。2024 年 11 月，市场传出，传音成立了光伏事业部，专注非洲市场，在旗下品牌 itel 官网上已经可以看到不少储能相关产品。



图为传音控股总部。

本报资料室/图

品牌形象，此前，其旗下的 techno、Infinix 等品牌就在希望从之前主打 100 美元以下价位段产品上探到 100—199 美元、200 美元以上更高价格段，来提升产品毛利率。

钟晓磊还告诉记者，传音此前发布的双折叠屏机型主要在印度和中东市场投放，出货量相对有限，也主要是用于试水和提升品牌形象。

根据传音最新发布的财报数据，2025 年一季度，公司营业总收入为 130.04 亿元，同比下降 25.45%。而归母净利润为 4.90 亿元，同比下降达 69.87%。扣除非经

常性损益的净利润 3.43 亿元，同比下降 74.64%。

谈及今年第一季度财报营收和利润下滑的原因，传音方面亦在前不久的投资者活动上表示，受市场竞争以及供应链成本综合影响，公司 2025 年一季度营业收入及毛利额有所减少。

从最新的市场情况来看，传音面临的的市场压力仍在持续。国际数据公司（IDC）数据显示，传音全球市场 2025 年第二季度市场出货量同比下滑 1.7%。Canalys（现并入 Omdia）数据亦显示，该季度，传音手机全球出货量同比下滑 2%。

更有消息显示，传音布局两轮电动车业务的时间更早，此前已经推出了电动两轮车品牌 Revoov 和 TankVolt，其中，Revoov 主要在南亚、拉美等地区销售，而 TankVolt 主要在非洲市场。

谈及公司在发展除消费电子以外的业务战略与想法，传音方面向记者回应，面对新兴市场日益增长的智能终端设备需求和数字经济发展机遇，传音正加快推进“手机+移动互联网服务+家电、数码配件等扩品类”的商业生态模式，通过多业务的协同不断加深公司护城河。

面对手机市场竞争加剧的情况，传音方面亦表示，公司未来将持续推进手机业务稳健拓展，强化中高端产品突破，坚持以用户价值为导向，加大研发资源投入，在影像、AI、充电、基础体验等技术领域重点打造产品价值点，提升中高端产品竞争力。

钟晓磊预计，2025 年下半年，智能手机厂商将面临更大成本压力，尤其是内存价格上涨对中低端产品线的压力，行业承压。预计全年手机销量持平，传音也正探索差异化方案，拟发力高价位产品寻求增量。

钟晓磊认为，传音多元化业务发展的优势是其深耕非洲市场多年，凭借对市场的深度理解与渠道优势，可快速推出符合本地需求的解决方案。

传音 2024 年年报数据显示，传音控股将营业收入明确划分为手机销售和其他产品收入，其中手机销售收入为 631.97 亿元，收入占比为 93.68%，同比增长 10.2%。其他产品收入为 42.59 亿元，收入占比 6.31%，同比增长 7.25%，“其他业务”虽然增长，但尚未成为业绩支柱。

而新业务何时能成为第二增长曲线仍待时间观察与市场检验。

RISC-V 中国突围 AI 时代与 x86、ARM 三分天下

中经记者 李玉洋 上海报道

不再仅仅是指令集架构名义上除 x86、ARM 之外的一个选择，RISC-V（第五代精简指令集）如今已有与前两者“三分天下”的实力。

指令集架构（ISA）是处理器提供供给软件（操作系统、编译器、应用程序）的抽象接口，RISC-V 以开放标准与灵活架构正成为全球芯片创新的重要驱动力。“展望中国未来 CPU 的发展，能够同时自主、可控、繁荣三大特征的指令集架构，

累计出货量将突破 200 亿颗

据了解，RISC-V 自 2010 年问世以来，在全球学术界和产业界共同努力下推动下，逐步迎来爆发式增长，目前已与 x86、ARM 成为全球最重要的三种处理器指令集架构。

2022 年，RISC-V 国际基金会宣布，全球搭载 RISC-V 核心的芯片出货量总计超过 100 亿颗。达成这个目标，RISC-V 用了 12 年，而 ARM 用了 21 年，x86 则花了大约 30 年乃至更久时间。

记者注意到，有着“RISC-V 之父”称号的 RISC-V 国际基金会首席架构师 Krste Asanovic 和知名 RISC-V 领域创业公司 Tenstorrent 首席执行官 Jim Keller（被外界称为“架构师大神”）以不同形式出现在本届 RISC-V 中国峰会上，着实不多见。

“过去十年，CPU 性能提升主要靠制程；未来五年，灵活指令集与开源协作带来的变化将比前十

RISC-V 几乎成为必选项。”在日前举办的第五届 RISC-V 中国峰会上，芯原股份（688521.SH）创始人、董事长兼总裁，上海开放处理器产业创新中心理事长戴伟民如是表示。

中国是 RISC-V 大国。据工信部电子信息司副司长史惠康在峰会上介绍，2024 年全球基于 RISC-V 指令集的芯片出货量已有数百亿颗，其中有一半以上来自中国。

如今，RISC-V 应用在高性能计算、人工智能、服务器、汽车电子等相关领域均取得了突破。

年的总和还多。”Jim Keller 表示 RISC-V 的开放性正催生前所未有的创新速度。此外，Tenstorrent 还首次系统披露公司“开放式芯粒架构（OCA）”路线图。

Tenstorrent 首席架构师练维汉表示，OCA 预计可将单颗芯片研发成本从 10 亿—20 亿美元降至数亿美元量级。同时，Tenstorrent 公布了 CPU 产品蓝图：代号 Ascalon 的 RISC-V CPU 核心达到了“与最新 AMD Zen 4/5 差不多的性能”，未来两三年性能还将以每年约 10% 的速度提升；并计划在 2027 年推出全世界最快的 CPU Callander。

此外，科技圈的明星企业英伟达也罕见阐述了其 RISC-V 产品策略。英伟达硬件工程副总裁 Frans Sijstermans 透露，英伟达正积极推进 CUDA 向 RISC-V 架构的移植工作，此前 CUDA 仅部署于 x86 与 ARM 架构。

Frans Sijstermans 还补充说，

“RISC-V 生态肉眼可见地日益壮大了，目前高通、英伟达、英飞凌等芯片大厂都明确表态支持 RISC-V。整体来看，RISC-V 已经进入大爆发的前夜。”电子创新网创始人张国斌告诉《中国经营报》记者。

值得注意的是，RISC-V 在 HPC（高性能计算）这些高端市场的表现也越来越好。RISC-V 国际基金会 CEO Andrea Gallo 表示，RISC-V 已从嵌入式计算领域延伸至存储技术和高性能计算领域，充分展现了该架构的强劲势头。

NVLink Fusion 现在也支持客户用自己的 RISC-V CPU，不再只是传统的 x86/ARM 架构 CPU，即整合 RISC-V CPU、GPU、网络芯片及 NVLink 互连技术，构建完整的数据中心级架构。

相关数据显示，英伟达 2024 年基于 RISC-V 的 GPU 出货已超 10 亿颗。不过，需要指出的是，英伟达在现有 GPU 之中用上了定制的 RISC-V 控制器，主要用于电源、显示与安全等相关的管理工作，很难被视作 GPU 主体。

“在 EDA 工具领域，新思、华大九天、合见工软等领先厂商也大力支持 RISC-V，在产品品类方面，RISC-V 已经覆盖了 CPU/DSP/MCU、算力处理器、汽车电子等多个领域。”张国斌表示。

市场研究机构 SHD 预测，到 2031 年 RISC-V 芯片累计出货量将突破 200 亿颗，广泛渗透消费电子、汽车、HPC 等领域。

主流之路仍需努力

业界有观点认为，与 x86 在 PC 和服务 器、ARM 在移动手机上建立的生态相比，RISC-V 生态最主要的问题是“专用有余、通用不足”。

“RISC-V 的应用足迹已遍及嵌入式领域的多个关键场景，但整体基础仍不够坚实，发展结构呈现‘专用有余、通用不足’的特征。”芯来科技创始人胡振波坦言。

从物联网领域的“轻量级玩家”到高性能计算的“挑战者”，RISC-V 亟待一场从专用走向通用的关键蜕变，寻找下一个 iPhone 时刻。

以 RISC-V 在 HPC（高性能计算）领域的发展为例，半导体行业资深产业分析师黄烨锋表示，大部分人几乎都默认 RISC-V 用于高性能领域不存在任何问题，这已是共识。“今年的 RISC-V 中国峰会主论坛演讲，已经有过半演讲人都在谈 HPC。而且

有望三分天下

“没有中国的创新与支持，就没有今天的 RISC-V。”RISC-V 国际基金会首席执行官 Andrea Gallo 表示。

2019 年至 2020 年，RISC-V 在物联网智能家居为主的嵌入式市场迎来第一波爆发。国内相继出现了大量本土 RISC-V 公司，包括做 RISC-V IP 的芯来科技、赛坊科技，也有京东方创始人王东升创办的 RISC-V 公司奕斯伟计算。

从 A 股公司来看，兆易创新（603986.SH）、中科蓝讯（688332.SH）、乐鑫科技（688018.SH）等厂商，均在 2019 年至 2020 年，初次发布基于 RISC-V 的芯片产品；

和过去两三年有显著差异的是，这些演讲者几乎都已经不再将重点放在自家 RISC-V 产品的性能参数上。”他说。

RISC-V 虽然今非昔比，但未来要走向主流 HPC 让有工作要做。高通资深副总裁 Leendert van Doorn 表示，随着 RISC-V 芯片最终要做规模与算力扩展，那么参与者们势必必要拥抱平台与生态思维。

他认为开放标准和社区合作，是 RISC-V 本身已有的优势，尤其指令集的矩阵、AI 相关的扩展，以及不同版本的 Profile 配置（用于区分不同环境或应用场景的个性化设置方案），令该指令集及生态能够以相对一致的步调适配于各类不同应用。

“在此基础上，首先要有平台思维。除了 CPU 之外，还要考虑加速器、IO 控制器、总线、固件与软件，各种平台功能标准化，以及充分利用现有生态（如复用已经

得到证明的标准）、裁剪后的平台 Profile。”Leendert van Doorn 还指出，即便 ARM 在服务器市场做了很长时间，但其生态的成熟性仍远不及 x86。

针对“生态系统思维”，Leendert van Doorn 提到的一个重要建议是尽早去做二进制转译，以及诸如 ARM64EC 这样的混合解决方案（原生与模拟代码混合运行）。

虽然目前 RISC-V 还存在软件生态不成熟的弊端，但在众多头部厂商的押注和引领之下，进军高性能计算市场，RISC-V 的短板正快速补齐。

以 SiFive、Ventenna、Tenstorrent 为代表的国际 RISC-V 厂商，主要在高性能、Chiplet、RISC-V DataFlow 方向布局；而国内以开芯院、知合计算、进选时控等为代表国产 RISC-V，则主要在产业生态、高性能、IOMMU 虚拟化等方向发力。

2031 年，RISC-V 架构处理器的出货将突破 200 亿颗，市场渗透率将达到 25.7%。届时，RISC-V 在主要的市场，如消费，计算机、汽车、数据中心、工业、网络等的市占率将分别达到 39%、33%、31%、28%、27%、26%。

阿里巴巴集团副总裁、达摩院玄铁团队负责人戚肖宁指出，RISC-V“在嵌入式领域，三分天下的局面已经形成，现在我们要往 HPC 方向上发展”。“我相信基于这样的趋势，RISC-V 在各领域都会三分天下，乃至在未来 15 年内，在高性能、大算力领域成为统治级架构。”戚肖宁表示。